

## MHS 5/09 V T3 B T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



## OMNIMATE® 4.0 - nästa utvecklingssteg

OMNIMATE® 4.0 följer trenden för One Cable Technology (OCT). Det modulära konceptet möjliggör snabb konfiguration av hybridgränssnitt, som överför data, signaler och energi i en enda anslutning. Det innebär att du kan minska kabelarbetet i en mängd olika applikationer, förenkla underhållet och påskynda automationsprocesserna. Den unika SNAP IN-anslutningen är ryggraden och snabbar upp kabeldragningsprocessen.

## Den snabbaste anslutningen hittills

- Snabb, säker och verktygslös kabeldragnings tack vare den unika SNAP IN-anslutningen
- Redo för robot genom "WIRE READY"-leverans med öppen klämpunkt
- Optisk och akustisk återkoppling indikerar korrekt kabeldragnings

## Skapa din egen konfiguration

- Flexibel konfiguration och beställning via Weidmüller Configurator (WMC)
- Leverans inom tre dygn, även för individuellt konfigurerade produkter
- Automatisk offertframtagning för den konfigurerade produkten

## Helt enkelt konfiguration av modulära hybridkontaktbänkar

- Flexibla kombinationsalternativ för överföring av ström, signaler och data
- Framtidssäker Single-Pair Ethernet-teknologi

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, THT/THR lödanslutning, Delning i mm (P): 5.00 mm, Antal poler: 9, 180°, Tube
Art.nr.	<a href="#">8000072454</a>
Typ	MHS 5/09 V T3 B T
GTIN (EAN)	4064675422969
Förp.	11 Stück
Produktparametrar	IEC: 400 V / 25.3 A UL: 300 V / 18.5 A
Förpackning	Tube

## MHS 5/09 V T3 B T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	11,9 mm	Byggdjup (tum)	0,469 inch
Höjd	17,2 mm	Bygghöjd (tum)	0,677 inch
Höjd lägstbyggande	14 mm	Bredd	46,38 mm
Byggbredd (tum)	1,826 inch	Nettovikt	7,336 g

## Systemparametrar

Produktfamilj	OMNIMATE 4.0	Anslutningstyp	Kretskortanslutning
Montering på kretskortet	THT/THR lödanslutning	Delning i mm (P)	5 mm
Delning i tum (P)	0,197 "	Anslutningsvinkel	180°
Antal poler	9	Antal lödstift per pol	1
Lödstiftlängd (l)	3,2 mm	Dimensioner för lödstift	1,0 x 1,0 mm
Diameter bestyckningshål (D)	1,4 mm	Tolerans diameter bestyckningshål (D)	+ 0,1 mm
Ytterdiameter för löddyna	2,3 mm	Schablonhålsdiameter	2,1 mm
L1 i mm	40 mm	L1 i tum	1,575 "
Antal rader	1	Polradstal	1
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57	Kontaktsäker ovanför kretskortet	Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470	IP 20
Skyddsklass	IP20	Genomgångsmotstånd (6)	≤5 mΩ
Stickcykler	≥ 25	Max. instickskraft/pol	8,5 N
Max. dragkraft/pol	8,5 N		

## Materialdata

Isoleringsmaterial	PA 9T	Färgkod	svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Isoleringsmaterialgrupp	I
CTI (Comparative Tracking Index)	≥ 600	Moisture Level (MSL)	1
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Kontaktgrundmaterial	CuMg
Kontaktmaterial	Cu-legering	Kontakttyta	förtennad
Typ av förtinning	matt	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, max.	55 °C	Driftstemperatur, min.	-50 °C
Driftstemperatur, max	100 °C		

## Märkdata enligt UL 1059

Institut (cURus)



Certifikat nr (cURus)

E60693

Märkspänning (användargrupp B / UL 1059)	300 V	Märkspänning (användargrupp D / UL 1059)	300 V
Märkspänning (användargrupp F / UL 1059)	420 V	Märkström (användargrupp B / UL 1059)	18,5 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059)	10 A	Hänvisning till godkännandevärden	Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.
Krypsträcka, min.	5,6 mm	Luftsträcka, min.	4 mm

## MHS 5/09 V T3 B T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Märkdata enligt IEC

testad enligt standard	IEC 60664-1, IEC 61984	Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)	25,3 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)	20,8 A	Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)	21,8 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)	18 A	Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad II/2	400 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/2	320 V	Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/3	250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad II/2	4 kV	Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/2	4 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/3	4 kV	Krypsträcka, min.	5,4 mm
Luftsträcka, min.	4 mm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

## Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet	Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext	<ul style="list-style-type: none"> <li>Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.</li> <li>P på ritningen = raster</li> <li>Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.</li> <li>Lödhålsdiameter D=1,4+0,1 mm</li> <li>Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last</li> <li>Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader</li> </ul>

## Godkännanden

Godkännanden



UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E60693

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">CoC_cURus_E60693_MPS_MHS_202207.pdf</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>
Kataloger	<a href="#">CAD data – STEP</a>
	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## MHS 5/09 V T3 B T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Ritningar

## Produktillustration



## Dimensional drawing



## Recommended wave soldering profiles

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Single Wave:



### Double Wave:



### Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

## Recommended reflow soldering profile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



## Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  $\leq +3\text{K/s}$ . In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at  $\geq -6\text{K/s}$  solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.